納 入 仕 様 書

Specification of Crystal Unit

FXQM-140038
(XRCGB26M000F3A00R0)

決定年月日 March 19, 2015
Date

PRELIMINARY

1. 適 用 Scope

当納入仕様書は、車載用マイクロコンピュータ等のクロック発生回路に使用する水晶振動子について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。
This product specification is applied to the crystal unit used for time base oscillator in a microcomputer for automotive. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

2. 品番 及び 貴社関連事項 Part Number

2-1	当社品番 Murata Part Number	:	FXQM-140038(XRCGB26M000F3A00R0)
2-2	貴社部品番号 Customer's Part Number	:	
2-3	貴社仕様書番号 Customer's Drawing Number	:	

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1	外観 Appearance	: :	目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。 No illegible marking. No visible dirt.
3-2	外形寸法図 Dimensions of component	: :	製品単体の形状を項目7に示します。 Please refer to item 7 for component dimensions.
3-3	構造 Construction	: :	アルミナ基板に、水晶素子を接着し、金属キャップで蓋をしております。 Crystal element is mounted onto alumina substrate, then metal cap covers over the element.

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com
微信扫码咨询客服

4. 最大定格 Maximum Rating

	項 目 Item	規 格 Specification
4-1	動作温度範囲 Operating Temperature Range	-40 to +125°C
4-2	保存温度範囲 Storage Temperature Range	-55 to +125°C
4-3	最大励振レベル Maximum Drive Level	300 μW 以下/max.
4-4	直流印加電圧 D.C. Voltage	D.C.6V 以下/max.
4-5	入力信号振幅 A.C. Voltage	15Vp-p 以下/max.
4-6	耐電圧 Withstanding Voltage	D.C.100V 以下/max. 5s 以内/max.

5. 電気的性能 Electrical Characteristics

	項 目 Item	規 格 Specification
5-1	公称周波数 Nominal Frequency	26.0000MHz
5-2	周波数許容偏差 *1 Frequency Tolerance *1	±30ppm 以内/max.
5-3	等価直列抵抗 *1 Equivalent Series Resistance *1	80Ω 以下/max.
5-4	絶縁抵抗 *2 Insulation Resistance *2	500MΩ 以上/min. (D.C.10V 印加時) (Applied D.C.10V)
5-5	周波数温度依存性 Frequency Shift by Temperature	±35ppm 以内/max. (-40 to 125°C) （初期値に対し/from initial value）
5-6	周波数エージング Frequency aging	±2ppm 以下/年 max./year
5-7	負荷容量 (Cs) Load Capacitance	6±0.1pF

*1 周波数および等価直列抵抗の測定条件は6項を参照ください。
Please refer item 6 for measuring method of frequency and Equivalent Series Resistance.

*2 端子相互間での抵抗を示します。
This characteristic shows the resistance between terminals.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

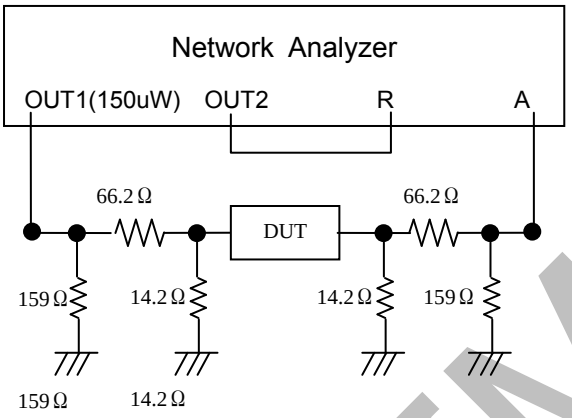
6. 測定方法 Measuring Method

6-1 周波数測定方法:

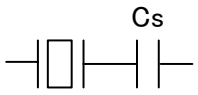
5項で示す周波数は、第1-1図で示す回路とネットワークアナライザ(Agilent E5100Aもしくは相当品)にて測定した負荷時共振周波数(共振点近傍において、電気的インピーダンスが抵抗性となる2つの周波数のうち、低い方の周波数)を示します。DUTは第1-2図に示します。負荷容量値(Cs)は5-7項を参照ください。負荷時共振周波数の規格値は、励振レベル：150μWで測定した値です。

Frequency measuring method:

Frequency mentioned the item 5 means the load resonance frequency(Lower frequency of the two given when the electrical impedance of the component becomes resistant near its resonance point) measured by network analyzer (Agilent E5100A or the equivalent) and the circuit in Figure.1-1. DUT is shown in Figure 1-2, and the value of a load capacitor(Cs) is referred to the item 5-7. The load resonance frequency is measured at drive level of 150μW.



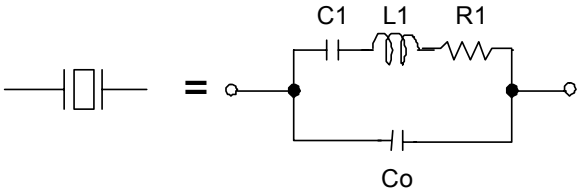
第1-1図 周波数測定回路
Figure 1-1 Frequency measuring circuit



第1-2図 DUT(被測定デバイス)
Figure 1-2 DUT（Device Under Test）

6-2 等価直列抵抗 ：5項に示す等価直列抵抗(R1)は、第1-1図で示す回路とネットワークアナライザ(Agilent E5100Aもしくは相当品)にて測定します。DUTは第1-3図に示します。

Equivalent series resistance : The equivalent series resistance (R1) which mentioned in item 5 is measured by network analyzer (Agilent E5100A or equivalent) and the circuit in Figure.1-1. DUT is shown in Figure 1-3.



第1-3図 DUT（被測定デバイス）
Figure 1-3 DUT（Device Under Test）

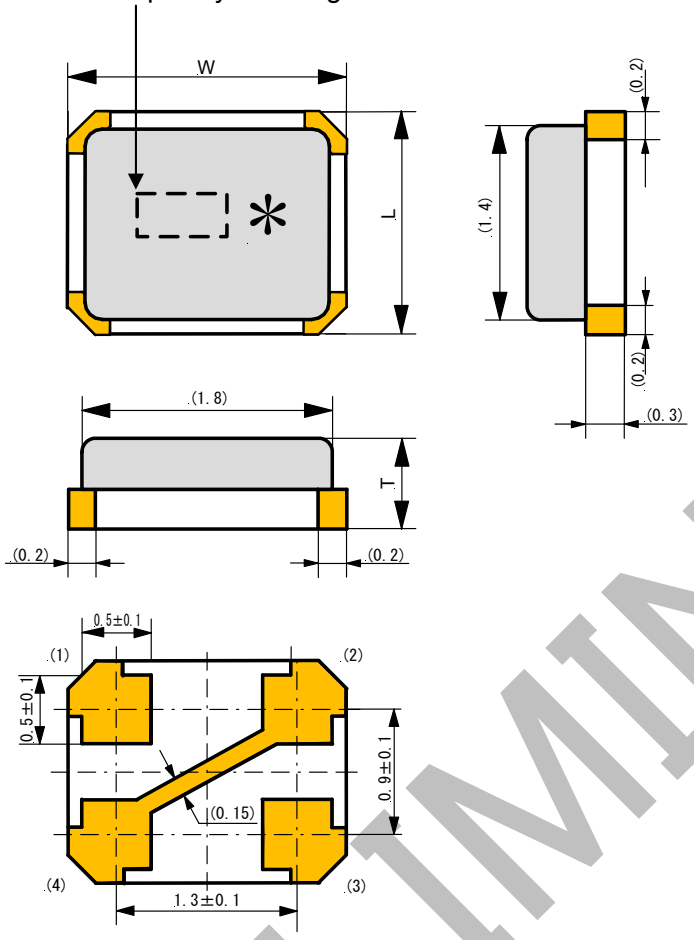
6-3 測定条件 ：温度+25±3℃、湿度45～85%R.H.を標準測定状態とします。
Measuring Condition : Standard conditions for the measurement shall be +25±3°C temperature and the humidity of 45 to 85%R.H. .

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

7. 外形寸法図 Dimensions

周波数表示
Frequency Marking



W : 2.0±0.1
L : 1.6±0.1
T : 0.65±0.05

周波数表示 : N
Frequency Marking

＊ : 製造年月日
EIAJ Monthly Code

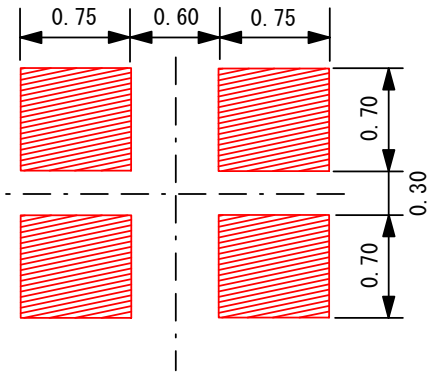
単位 : mm
Unit

( ) : 参考値
Reference

端子番号 Terminal Number
(1) 入出力 Input / Output
(2) (4) ノーコネクト No connect
(3) 入出力 Input / Output

(1)、(3)端子に極性はありません。
There is no polarity in the terminal (1),(3).

（推奨ランド寸法）
(Recommendable Land Pattern)



第2図 外形寸法図

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

Figure 2. Dimensions

月 Month / 年 Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003, 2007, 2011, 2015, 2019	a	b	c̄	d	e	f	g	*h*	j	*k*	*l*	m
2004, 2008, 2012, 2016, 2020	n	*p*	*q*	r	*s*	t	u	*v*	*w*	*x*	*y*	*z*
2005, 2009, 2013, 2017, 2021	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
2006, 2010, 2014, 2018, 2022	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

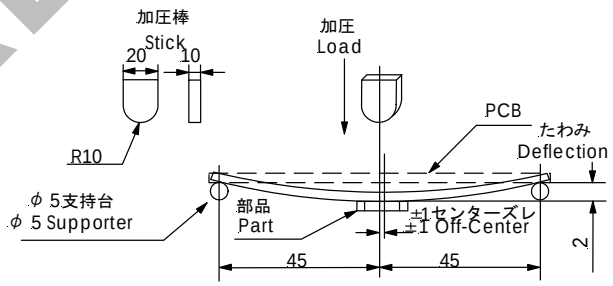
製造年月度 / EIAJ Monthly Code

（注）４年で１サイクルとなります。 / (note) The number is cycled by 4years.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

8. 機械的性能 Physical Characteristics

	項 目 Item	試 験 条 件 Test Condition	試験後の規格 Specification After Test
8-1	衝撃 Mechanical Shock	製品を試験用基板に実装した状態で、加速度100G(980m/s^2)、作用時間6msの衝撃を6面に各3回加えた後測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be measured after being applied 3 successive shocks, 100G(980m/s^2) for 6ms in the directions of 6 sides. Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表3及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 3 and Item 5-3.
8-2	振動 Vibration	製品を試験用基板に実装した状態で、振動周波数10～2000Hz、5G(49m/s^2)の振動をX,Y,Zの3方向にそれぞれ各4時間印加後測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be measured after being applied vibration of 5G(49m/s^2) with 10 to 2000Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular direction for 4 hours.Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表3及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 3 and Item 5-3.
8-3	基板たわみ Board Flex	下図に示すたわみ試験用プリント基板に実装し、たわみ量 2mm になるまで毎秒 0.5mm の速さで加圧し、60+5/-0 秒間保持します。試験方法は AEC-Q200 REV D に準拠します。 Apply pressure in vertical direction shown in right figure at a rate of about 0.5mm/s until bent width reaches 2mm and hold for 60+5/-0 seconds.Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.  	表3及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 3 and Item 5-3.

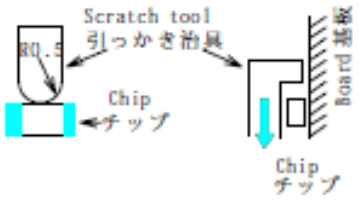
PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

8-4	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat (1)リフロー方式 (1)Re-flow Soldering	製品単品状態でリフロー炉(ピーク温度 260±5℃、1.0±0.5 秒、その他条件は 12-5-2 項を参照)に 2 回通した後、室温に取り出し 24 時間後測定します。試験方法は IEC60068-2-58 に準拠します。 Component shall be measured after 2 times re-flow soldering and leaving at room temperature for 24 hours. For soldering profile, refer to item 12-5-2 (Peak temperature is 260±5°C for 1.0±0.5s). Testing procedure is in accordance with IEC60068-2-58.	表1および5-3を満足します。 The measured values shall meet table 1 and item 5-3.
	(2)コテ付け方式 (2)Soldering with iron	PCB上にて温度+350±5℃で5.0±0.5秒間当て、室温に24時間放置後に測定します。但し、はんだこて先は電極部に直接接触しない事とします。試験方法はIEC60068-2-58に準拠します。(12-5-3項を参照) Component shall be measured after soldering on PCB at +350±5°C for 5.0±0.5s and leaving at room temperature for 24 hours. The soldering iron shall not touch the component while soldering. Testing procedure is accordance with IEC60068-2-58. (Refer to item 12-5-3)	外観に異常がなく、表2および5-3を満足します。 No visible damage and the measured values shall meet Table 2 and item 5-3.
	(3)はんだディップ方式 (3)Solder Dip	製品端子部を+260±5℃の溶融はんだ中に10±1秒間浸した後、室温に取り出し24時間放置後測定します。試験方法はJESD22-B106に準拠します。 The terminals of component shall be immersed in a soldering bath at +260±10℃ for 10±1s by only to level to cover. Component shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is in accordance with JESD22-B106.	表 3 および 5-3 を満足します。 The measured values shall meet table 3 and item 5-3.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

8-5	はんだ付性 Solderability	無鉛はんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.、4時間のエージングをし、端子部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、+245±5℃の溶融はんだ中に3±0.5秒間浸します。試験方法はIEC60068-2-58に準拠します。 Lead free solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C and 100%R.H. for 4 hours, and being placed in a rosin-methanol for 5s, the terminals of component shall be immersed in a soldering bath at +245±5°C for 3±0.5s. Testing procedure is accordance with IEC60068-2-58.	端子の95%以上にはんだが付着します。 The solder shall coat at least over ninety five (95) % of the terminal surface.
	はんだ付け性(2) Solderability(2)	PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.、4時間のエージングをし、当社推奨ランドの試験用基板（図4参照）に実装します。実装条件は12-5-1、12-5-2項に従います。 After being kept in pressure cooker at +105°C and 100%R.H. for 4 hours, and the componet shall be mounted on our test board (refer to Fig.4). For soldering conditions and profile refer to item 12-5-1 and 12-5-2.	基板側面電極、1/4t以上はんだが濡れます。 The solder shall wet a side of substrate more over 1/4t (t is a thickness of substrate.)
8-6	固着強度 Terminal Strength	R0.5の引っかき治具を使用して、矢印の方向に17.6Nの静荷重を加えて60秒間保持します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test PCB. Then a static load of 17.6N using a R 0.5 scratch tool shall be applied on the core of the component and in the direction of the arrow and held for 60s.Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.  	表 3 及び 5-3 を満足します。 The measured values shall meet Table 3 and Item 5-3.

PRELIMINARY

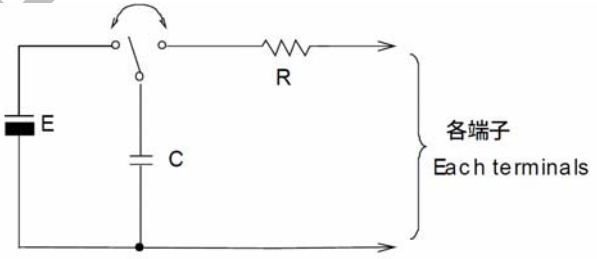
深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

9. 耐候性能 Environmental Characteristics

	項 目 Item	試 験 条 件 Test Condition	試験後の規格 Specification After Test
9-1	高温放置 High Temperature Exposure(Storage)	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+125℃の恒温槽中に1000時間保持し、室温に取出し、24時間後に測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be kept in a chamber at +125°C for 1000 hours. And then it shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表4及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.
9-2	低温放置 Cold (Storage)	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55℃の恒温槽中に1000時間保持し、室温に取出し24時間放置後に後測定します。試験方法はIEC60068-2-1に準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be kept in a chamber at -55±2°C for 1000 hours. And then it shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is accordance with IEC60068-2-1.	表4及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.
9-3	高温高湿通電 Biased Humidity	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+85℃, 湿度85%R.H.の恒温恒湿槽にD.C.6Vを印加しながら1000時間保持し、室温に取出し、24時間放置後に測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be kept in a chamber at 85℃, 85%R.H. on loading D.C.6V for 1000 hours. And then it shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表4及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

9-4	熱衝撃 Temperature Cycling	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55℃の恒温槽中に30分間保持後、温度+125℃の恒温槽中に直ちに移し、30分間保持する。これを1サイクルとし、1000サイクル行い、室温に取出し24時間放置後に測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. After performing 1000 cycles of thermal test (-55℃ for 30 minutes to +125℃ for 30minutes), it shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表4及び5-3を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.
9-5	高温通電 Operational Life	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+125℃の恒温槽中にD.C,6Vを印加しながら1000時間保持し、室温に取出し、24時間後に測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 Component shall be soldered on the test board. Then it shall be kept in a chamber at +125°C on loading D.C.6V for 1000 hours. And then it shall be measured after leaving at room temperature for 24 hours. Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.	表 4 及び 5-3 を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.
9-6	耐静電性 Electro Statics Discharge	下記の回路において、電圧Eでコンデンサに蓄えられた電荷を、抵抗Rを介し各端子間に放電した後測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。 E=±500V , C=150pF , R=2.0kΩ,Direct Contact Component shall be measured after applying surge voltage (E) by discharging capacitor (C) through resistor (R). Testing procedure is in accordance with AEC-Q200 REV D.  	表 4 及び 5-3 を満足します。 The measured values shall meet Table 4 and Item 5-3.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

表1　Table 1.

周波数変動量 Frequency deviation	±5ppm 以内 (初期値に対し) ±5ppm max. (from initial value)

表2　Table 2.

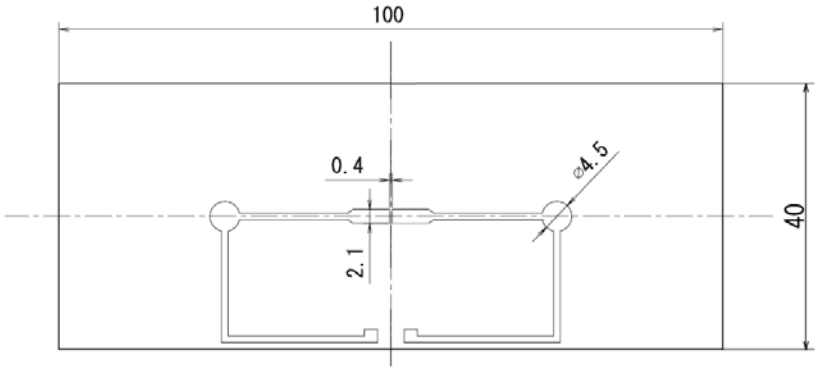
周波数変動量 Frequency deviation	±10ppm 以内 (初期値に対し) ±10ppm max. (from initial value)

表3　Table 3.

周波数変動量 Frequency deviation	±25ppm 以内 (初期値に対し) ±25ppm max. (from initial value)

表4　Table 4.

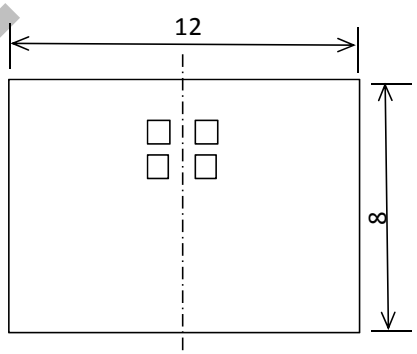
周波数変動量 Frequency deviation	±40ppm 以内 (初期値に対し) ±40ppm max. (from initial value)



プリント基板材質 PCB Material	ガラスエポキシ(FR4) Glass Epoxy(FR4)
基板厚み PCB Thickness	1.6mm

単位：mm
in mm

第3図　たわみ試験用プリント基板
Figure 3.　PCB for Bending Strength Test



プリント基板材質 PCB Material	ガラスエポキシ(FR4) Glass Epoxy(FR4)
基板厚み Board Thickness	1.0mm

単位：mm
in mm

第4図　試験用基板
Figure 4.　Test Board

PRELIMINARY
深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

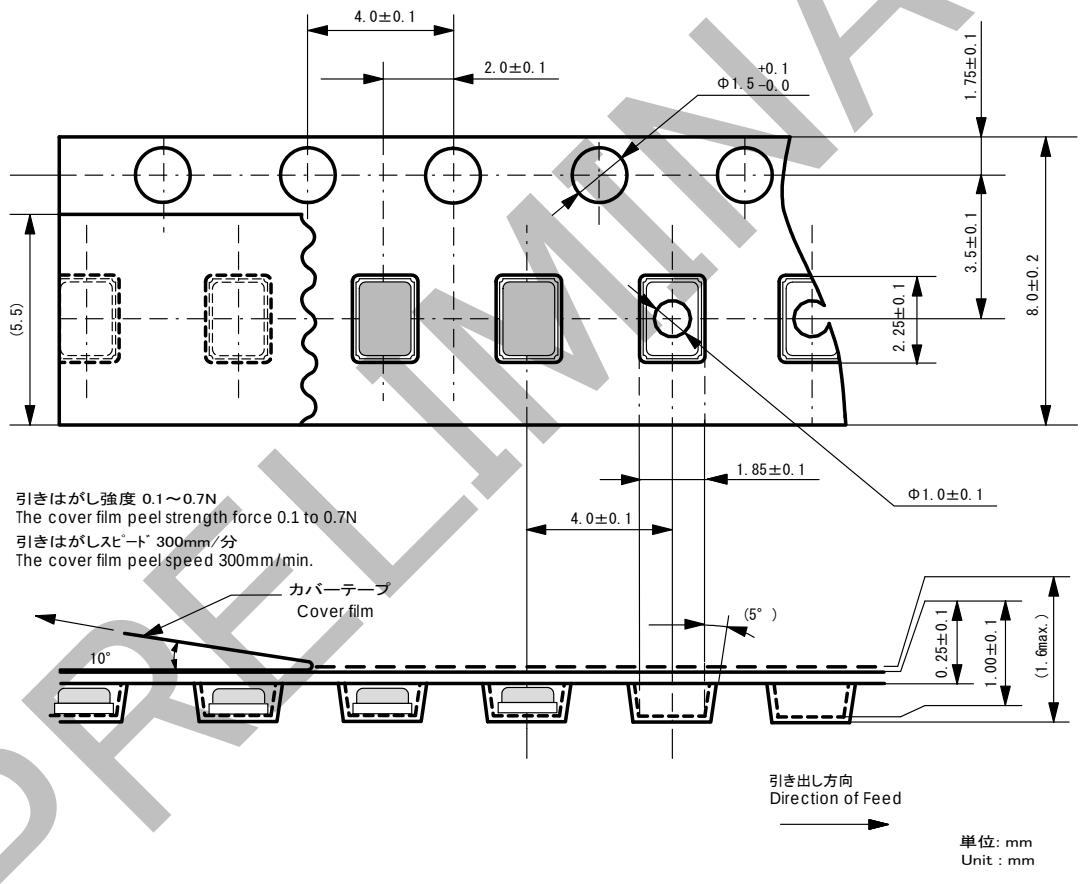
10. テーピング品包装規格　Packaging Standard (Taping)

10-1　テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる向き)とします。
The tape for components shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user.

10-2　チップは、1リール 3,000個収納します。
A reel shall contain 3,000pcs of components.

10-3　プラスチックテープの外形寸法図を第5図に示します。
Dimensions of plastic tape are shown in Figure 5.

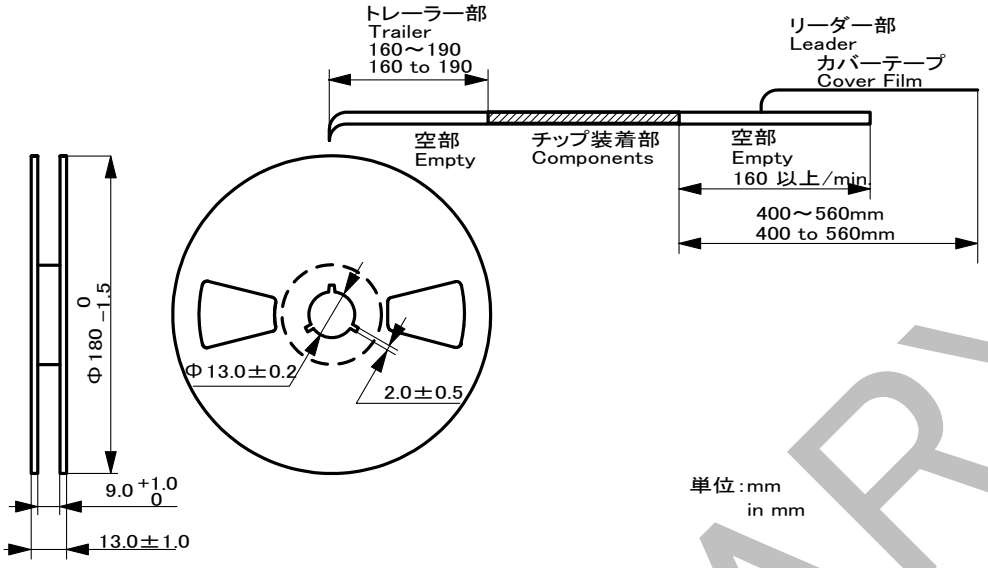
10-4　プラスチックリールの外形寸法図を第6図に示します。
Dimensions of plastic reel are shown in Figure 6.



第5図　　プラスチックテープの外形寸法図
Figure 5.　Dimensions of Plastic Tape

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com



第6図　　プラスチックリールの外形寸法図
Figure 6.　Dimensions of Plastic Reel

11. ⚠ 注意　Cautions

11-1 用途の限定　Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。
①航空機器　②宇宙機器　③海底機器　④発電所制御機器　⑤医療機器
⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等)　⑦交通用信号機器　⑧防災／防犯機器
⑨情報処理機器　⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.
①Aircraft equipment
②Aerospace equipment
③Undersea equipment
④Power plant control equipment
⑤Medical equipment
⑥Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.)
⑦Traffic signal equipment
⑧Disaster prevention / crime prevention equipment
⑨Data-processing equipment
⑩Applications of similar complexity and/or with reliability requirements to the applications listed in the above

11-2　フェールセーフ機能の付加　Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

12. 使用上の注意　Caution for Use

12-1
過大な機械衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご注意下さい。
The component may be damaged if excess mechanical stress is applied.

12-2
ご使用ＩＣ及び発振回路条件により、発振不具合（異常発振あるいは発振停止）が発生する場合がありますので、回路条件を充分ご確認の上ご使用下さい。発振余裕度については、負性抵抗マージンを発振子の等価直列抵抗規格の値の5倍以上確保できるように回路設計してください。
Irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions. Please design your oscillation circuit to get 5 times or more of a negative resistance against the maximum value of the Equivalent Series Resistance, that is specified in order to prevent oscillation stop.

12-3
当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さい。詳細については事前に当社までお問い合わせ下さい。
The component is recommended with placement machines employing optical placement capabilities. The component might be damaged by mechanical force depending on placement machine and condition. Make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines employing mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand.

12-4
実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。
Do not reuse components once mounted onto a circuit board.

12-5　はんだ付けに関する注意事項　Caution for Soldering
この製品はリフロー方式で実装をお願いします。
Please mount components on a circuit board by the re-flow soldering

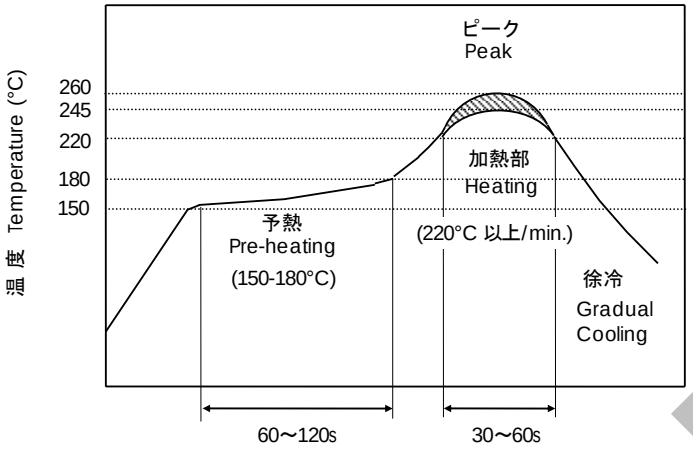
12-5-1　推奨するフラックスおよびはんだ　Recommendable Flux and Solder

フラックス Flux	ロジン系フラックスをお使いください。水溶性フラックスは使用しないでください。 Please use rosin based flux, but do not use water soluble flux.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。 クリームはんだ塗布厚は、0.10～0.15mmの範囲でお願いします。 Please use solder(Sn-3.0Ag-0.5Cu) under the following condition. Standard thickness of soldering paste : 0.10 to 0.15mm

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

12-5-2 推奨はんだ条件 Recommendable Soldering Profile



	標準プロファイル Standard soldering profile
予熱 Pre-heating	150°C to 180°C 60s to 120s
加熱部 Heating	220°C 以上/min. 30s to 60s
ピーク温度 Peak temperature	245℃以上/min. 260°C以下/max. 5s 以内/max.

*温度は部品表面付近で測定します。
*Temperature shall be measured on the surface of component.

12-5-3 こて付け条件 Reworking with soldering iron
やむを得ずはんだこてを使用して製品をはんだ付け・修正する場合は、以下の点に注意して行って下さい。
Please solder with soldering iron noting to the following conditions.

	条 件 condition
予熱温度 Pre-heating	150°C 60s
はんだこてのこて先温度 Heating of the soldering iron	350°C 以下/max.
はんだこてのワット数 Watt	30W 以下/max.
はんだこてのこて先形状 Shape of the soldering iron	φ3mm 以下/max.
はんだ付け時間 Soldering Time	5s 以内/max.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu
注意事項 Caution	製品に直接こて先がふれないようにしてください。こて先が製品に直接触れて過剰な熱が加わった場合、圧電素子の特性劣化や製品電極の破損につながる恐れがあります。 Please do not directly touch the components with soldering iron, because the terminals of components or electrical characteristics may be damaged if excess thermal stress is applied.

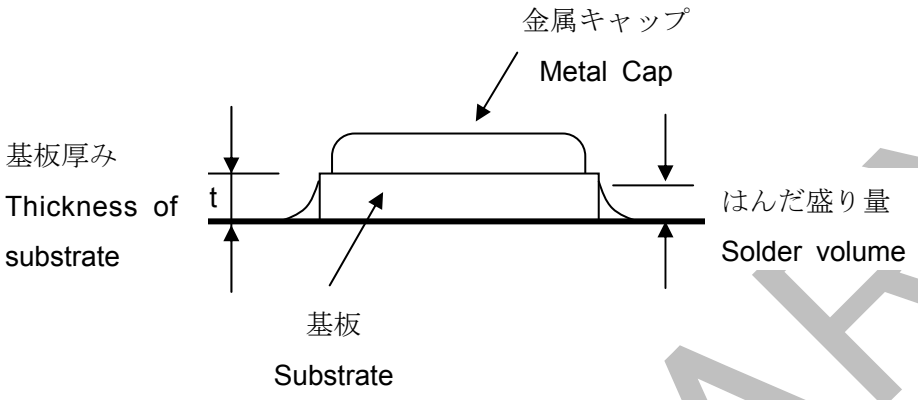
PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

12-5-4 はんだ盛り量 Solder Volume

はんだ盛り量は基板の高さ以下にしてください。基板を超えた場合、キャップと基板の封止部が破損する可能性があります。

Please make the solder volume below the height of the substrate. When exceeding the substrate, the damage of sealing part between the metal cap and the substrate may occur.



12-6 製品洗浄に関する注意事項 Caution for washing

塩素系洗浄剤、石油系洗浄剤、アルカリ系洗浄剤での洗浄により不具合が発生することがありますので、ご使用はお避け下さい。

The component may be damaged if it is washed with chlorine, petroleum or alkalicleaning solvent.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

13. 製品保管上の注意　Notice on product storage

13-1
温度-10～+40℃、相対湿度15～85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。
Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions : Temperature : -10 to +40 °C
Humidity : 15 to 85% R.H.

13-2
製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。
Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.
If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

13-3
酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。
Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

13-4
湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。
Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.

13-5
直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。
Please do not store the products in the places under direct sunlight, heat and vibration.

13-6
開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。
Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

13-7
製品落下により、製品内部の圧電素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。
Please do not drop the products to avoid cracking of piezoelectric element.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com

14. ⚠お願い Note:

14-1
ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

14-2
当製品を当納入仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
You are requested not to use our product deviating from this product specification.

14-3
お手数ですが、当納入仕様書に貴社受領印を押印の上、1部を弊社へご返却下さい。
３ヶ月以内にご返却いただけない場合、又は、当納入仕様書をご返却いただく前にご注文をいただいた場合は、当納入仕様書は、その時点で受領されたものとさせていただきます。
Please return one duplicate of this product specification to us with your signature to acknowledge your receipt. In case of no return within three months from submission date, or if we receive order before the duplicate is returned, this product specification will be deemed to have been received by you.

14-4
弊社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは適切ではないものと存じております。従って、もし、貴社が作成されたこれら技術資料に、品質保証、ＰＬ、工業所有権等にかかる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合は、当該記載は無効とさせていただきます。これらの事項につきましては、別途取引基本契約書等においてお申し越しいただきたくお願いします。
We consider it not appropriate to include any terms and conditions with regard to the business transaction in the product specifications, drawings or other technical documents. Therefore, if your technical documents as above include such terms and conditions such as warranty clause, product liability clause, or intellectual property infringement liability clause, they will be deemed to be invalid.

PRELIMINARY

深圳市满度科技有限公司
Web:www.manduic.com
Tel:150-1290-5940
Email:sales@manduic.com